



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于对深圳至正高分子材料股份有限公司
对外收购事项的问询函回复



中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

一、关于对深圳至正高分子材料股份有限公司
对外收购事项的问询函回复

1-14



关于对深圳至正高分子材料股份有限公司对外 收购事项的问询函回复

中审亚太审字[2022]007516号

上海证券交易所上市公司管理一部：

2022年11月9日，上海证券交易所上市公司管理一部出具了《关于对深圳至正高分子材料股份有限公司对外收购事项的问询函》（上证公函【2022】2639号，以下简称“《问询函》”），我们作为标的公司截止2022年6月30日净资产的审计机构。现就《问询函》中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况回复如下：

问题3. 公告披露，标的资产苏州桔云2021年实现营业收入4,042.73万元，净利润630.67万元，2022年上半年实现营业收入878.78万元，净利润162.75万元，前三季度实现营业收入6,168.42万元，净利润1,365.96万元。以此推算，2022年第三季度实现营业收入5,289.64万元，净利润1,203.21万元，经营业绩较往期大幅提升。此外，交易对方SUCCESSFACTORS承诺标的资产2022年、2023年、2024年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,350万元、1,890万元、2,646万元，标的资产2022年前三季度已实现净利润金额或已超过其2022年的业绩承诺。请公司补充披露：（1）标的资产所处行业情况，包括行业所处周期、行业政策、上下游情况、准入壁垒、竞争格局、市场占有率和行业发展趋势等；（2）标的资产的主要经营模式，并结合标的资产的经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有率等，分析标的资产的行业地位和竞争优势；（3）结合上述情况，说明标的资产第三季度业绩大幅提升的具体原因，与行业趋势是否相符，并分析标的资产盈利能力的可持续性；（4）标的资产今年前三季业绩是否已达到2022年业绩承诺，如是，请说明设置该等业绩承诺的合理性，相关约束力是否有限。请会计师发表意见。

一、标的资产所处行业情况，包括行业所处周期、行业政策、上下游情况、准入壁垒、竞争格局、市场占有率和行业发展趋势等

上市公司回复：

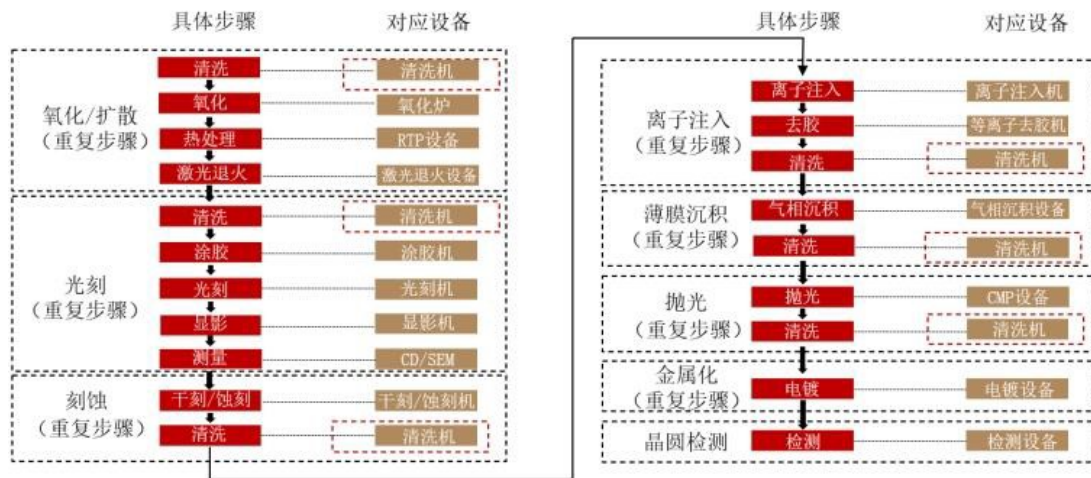
（一）标的资产所处行业概况及行业所处周期

1、半导体专用设备行业概述

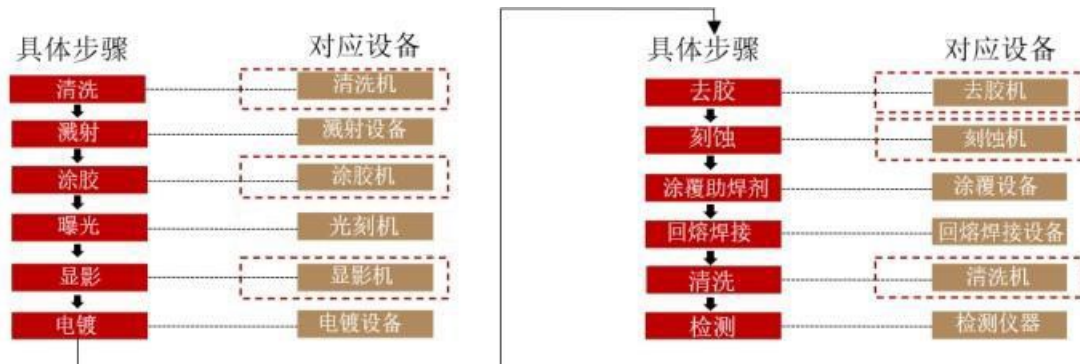
半导体产业链可按照主要生产流程划分为上游支撑产业、中游制造产业和下游应用产业。上游支撑产业为中游制造产业提供必要的原材料与生产设备，进行加工后应用于下游各个领域。标的公司所处的细分领域即为上游支撑产业中半导体专用设备。作为半导体产业链的基础和起点，其加工的品质、良率对芯片制造及下游应用具有重要决定作用，是半导体产业链中的重要环节之一。

半导体专用设备泛指用于生产各类半导体产品所需的生产设备，半导体专用设备是半导体产业的技术先行者，芯片设计、晶圆制造和封装测试等需在设备技术允许的范围内设计和制造，设备的技术进步又反过来推动半导体产业的发展。以半导体产业链中技术难度最高、附加值最大、工艺最为复杂的集成电路为例，应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）两大类，主要设计的工艺流程及设备类型如下图所示：

集成电路前道晶圆制造工艺流程图及对应设备



集成电路后道先进封装工艺流程图及对应设备



注：虚线方框为苏州桔云可生产设备

2、半导体专用设备市场规模及所处周期

半导体专用设备位于产业链的上游，其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。2013-2018年，在智能手机和消费电子快速发展的推动下，半导体设备市场进入了一个持续上升的行业周期，市场规模从318亿美元增长到了645亿美元，5年CAGR达15%；2019年受集成电路行业景气度下降影响，增长势头稍有回落，市场规模为598亿美元；2020年受益于存储器和传感器业务的快速发展，全球半导体市场规模回升，带动半导体设备行业增长，全球半导体设备市场规模达712亿美元，同比增长19%，创下了行业的历史新高；2021年全球半导体制造设备销售额激增，相比2020年的712亿美元增长了44%，达到1,026亿美元的历史新高。随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着产能扩张需求，预计将为半导体设备行业带来广阔的市场空间。根据SEMI预测，2022年全球半导体设备市场规模将相比2021年的1,026亿美元进一步增长15%至1,175亿美元，2023年预计将创下超过1,200亿美元的新高。

2016-2021年，中国大陆的半导体设备市场规模从64.6亿美元增长到了296.2亿美元，年CAGR达36%，在全球市场中的占比由15.7%提升至28.86%。根据SEMI统计，2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元，首次在全球市场排名首位，在全球市场中的占比达26.3%；2021年中国大陆再次成为半导体设备的最大市场，销售额达到296.2亿美元，同比增长58%，增速明显高于全球平均水平。2021年，中国半导体设备销售在全球范围的销售占比达到28.86%。

（二）行业政策

近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策，推动集成电路企业做大做强，提升在全球产业竞争格局中的地位和影响力，具体有关对的主要政策如下表所示：

序号	时间	发布机构	文件名称	主要内容
1	2021年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目	纲要提出应坚持创新驱动发展，强化国家战略科技力量，在事关国家安全和发

序号	时间	发布机构	文件名称	主要内容
			标纲要》	量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。
2	2021年	财政部、海关总署、税务总局	《财政部海关总署税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》(财关税〔2021〕4号)	集成电路用8英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件免征进口关税。
3	2021年	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021版）》	碳化硅同质外延片、碳化硅单晶衬底、8-12英寸硅单晶抛光片、8-12英寸硅单晶外延片属于关键战略材料领域的先进半导体材料。
4	2020年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国家鼓励的先进封装测试企业给予财税、投融资、研发、进出口人才、知识产权等方面的优惠政策。
5	2020年	财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
6	2019年	财政部、税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
7	2019年	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试。

（三）上下游情况

半导体专用设备行业的上游为电子元器件和机械加工行业，采购的原材料主要为机器人手臂、过滤器、阀门、传感器等，由于半导体专用设备具有高精度、高可靠性等特点，对原材料和零部件的要求也相应较高。

半导体专用设备行业的下游主要为晶圆制造和封装测试等行业。特别是集成电路产品技术含量高、工艺复杂，技术更新和工艺升级依托于专用设备的发展；反之，下游产业不断开发的新产品和新工艺，为设备行业提供了新需求和市场空间。

（四）准入壁垒

半导体设备行业属于战略性新兴产业，具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒。我国半导体专用设备制造业发展受到国家和各级政府的鼓励和支持，市场化程度较高，不存在行业限制或市场准入方面的行政管理。但半导体设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术含量高、技术研发周期较长以及产品工艺和制造技术难度大等特点，需要以高级专业技术人员和高水平研发手段为基础。因此，上述特性使得半导体行业具有较高的准入壁垒。

（五）竞争格局、市场占有率

我国半导体专用设备市场份额仍主要由国外知名企业所占据，凭借较强的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位。由于我国半导体专用设备行业整体起步较晚，先进设备制造仍相对薄弱，自给率还处于较低水平。近年来，在国家政策的推动下，我国半导体产业快速发展，整体实力显著提升，设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小。本土企业，包括标的公司在内的行业内少数半导体设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，拥有自主知识产权，具备一定品牌知名度，占据了一定市场份额。与国外知名企业相比，国内优势企业对客户需求的理解更加到位，服务方式更为灵活，产品性价比更高，具有一定的本土优势。

类别	外资品牌	国产品牌
光刻设备（含涂胶显影）	ASML、Nikon、Canon、TEL、DNS	上海微电子（光刻机）、芯源微（涂胶/显影机）、苏州桔云（涂胶/显影机）
刻蚀设备	LAM、TEL、AMAT	中微半导体、北方华创、苏州桔云
薄膜设备	AMAT、LAM、TEL	北方华创、沈阳拓荆
离子注入	AMAT、Axcelis	中科信、凯世通
过程控制	KLA、AMAT、日立	上海睿励、东方晶源
清洗设备	DNS、TEL、KLA、LAM	盛美上海、北方华创、至纯科技、芯源微、苏州桔云
化学机械研磨	AMAT、Ebara	华海清科、中电四十五所

类别	外资品牌	国产品牌
测试设备	泰瑞达、爱德万	长川科技、精测电子

（六）行业发展趋势

1、设备将向高精度化与高集成化方向发展

随着半导体技术的不断进步，半导体器件集成度不断提高。芯片特征尺寸不断缩小，硅片尺寸却不断扩大，半导体器件的结构也趋于复杂。因此对半导体设备的精度与稳定性的要求越来越高，未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展。

2、各类技术等级设备并存发展

虽然半导体技术持续迅猛发展，未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展，但是由于芯片的用途极其广泛，性能要求及技术参数等差异较大，各类性能、用途芯片大量并存应用，这也决定了不同的芯片产线需配置相匹配的、技术等级及性价比相当的半导体设备。因此，高、中、低各类技术等级的生产设备均有其对应市场空间，并存发展。

3、国产化进程加快

近年来，在国家政策的拉动和支持下，我国半导体产业快速发展，整体实力显著提升，设计、制造能力与国际先进水平不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，但半导体基础材料研究和先进设备制造仍然相对薄弱。为推动我国半导体产业的发展，国家先后设立国家重大专项和国家集成电路基金；地方政府也推出地方版集成电路投资基金，为半导体产业发展破解融资瓶颈提供了保障，有力促进了半导体行业的可持续发展。伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，本土半导体及其设备制造业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国半导体设备行业技术水平提高和行业的快速发展，从而进一步加快我国半导体设备的国产化进程。

会计师意见：

针对上述事项我们执行了以下审计程序：

1、了解标的公司主要所处行业情况；

2、与企业沟通公司所处行业情况，包括行业周期上下游情况、准入壁垒、竞争格局、市场占有情况等。

结论：经核查，我们未发现公司关于标的资产所处行业情况，包括行业所处周期、行业政策、上下游情况、准入壁垒、竞争格局、市场占有率和行业发展趋势等的说明存在重大异常。

二、标的资产的主要经营模式，并结合标的资产的经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有率等，分析标的资产的行业地位和竞争优势

上市公司回复：

（一）标的资产的主要经营模式

1、盈利模式

标的公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路制造与封测领域公司销售清洗机、腐蚀机、烘箱、分片机等产品实现收入和利润，标的公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售，同时有少量设备相关配件销售及维修服务收入。

2、研发模式

标的公司主要采用自主研发的模式，不存在合作研发或者委托开发。标的公司研发部门以半导体专用设备国际技术动态、客户需求为导向，自主研发新工艺、新技术，并进行技术方案的验证。

3、采购模式

标的公司在满足客户需求基础上，以相对经济的方式组织物料采购及生产作业。对较短交期及通用、有现货的原物料件，标的公司按生产计划管理的原则按需采购；对于长交期料件，标的公司则会依据市场预测及生产计划管理采取备货式生产，通常对于高价长交期物料，公司将与供应商协商开放式的订单，确保供应稳定及价格的弹性。

4、生产模式

标的公司主要实行订单式生产，在与客户签订订单或确定意向后，根据客户需求进行产品定制化设计及生产制造，以满足客户差异化需求。受标的公司发展历史影响，同时出于控制成本、保障交期的目的，标的公司现阶段半导体设备中使用的部分关键零部件及材料主要从海外采购或外协生产。本次交易完成后，标的公司将逐步实现核心部件的采购及外协组装转移至境内。

5、销售模式

标的公司采用“直销为主、代销为辅”的模式销售产品，主要通过商务谈判、招投标等方式直接获取订单，也存在通过代理商代销少量产品。

（二）标的资产的研发能力

标的公司自成立起即专注于研发半导体设备。湿制程方面，标的公司自主研发的湿制程设备 8 腔设计运用业界前沿、支持晶圆正负 5mm 翘曲；清洗机在集成电路后道先进封装领域技术水平与国际知名企业基本持平，并持续向前道工艺拓展；干制程方面，标的公司是行业少有的推出全自动烘箱的企业，公司的烘箱可同时烘烤 104 片，占地空间小节省一半空间，且四腔体皆可独立配方运作；涂胶显影设备方面，标的公司的技术水平仍弱于国际知名企业。从技术发展趋势上来看，尽管与国际领先水平尚有差距，但发展势头强劲。

（三）标的资产的市场占有率及行业地位

近年来随着中国半导体终端应用市场规模的不断增长，中国半导体制造、封测、材料和专用设备等行业迅速发展。但目前国内半导体专用设备厂商与国际巨头相比，在适用技术节点、市场占有率等方面仍有一定的差距。

半导体设备行业是典型的技术密集、资金密集型行业，具有较高的技术和资金门槛，同时由于对半导体生产环节具有重要影响，厂商不会轻易更换设备供应商，因此同时兼具一定的客户认知门槛，上述门槛和壁垒导致国产半导体设备供应商较少。标的公司专注于后道先进封装领域设备的研发，并逐步向前道拓展，围绕清洗设备、烘箱设备等持续深耕细作，形成自身独特的产品及技术优势，并凭借其较高的性价比优势和定制化、快速响应的客户服务优势不断扩大市场份额。产品和技术方面，标的公司自主研发的清洗设备在后道先进封装领域技术相对领先，在定制化服务、交货周期等方面有一定竞争优势，能够深度绑定知名客户，并已基本具备出货前道的技术能力；自主研发的全自动烘箱可实现烘烤流程全自动化，同时烘烤 104 片，大幅提升生产效率，国内厂商尚无对标产品。客户方面，标的公司已建立良好合作关系的客户包括江阴长电先进封装有限公司、浙江禾芯集成电路有限公司、江苏芯德半导体科技有限公司、全球化半导体设计与制造企业 T 公司等知名半导体企业。标的公司产品在优质客户中已取得良好的口碑和市场影响力，并凭借长电科技等知名客户进一步增强其市场地位和品牌知名度，为后续持续提高市场份额奠定了坚实的基础。

（四）标的资产的竞争优势

1、产品种类布局较广，深度服务客户，成长性较高

标的公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，能提供半导体湿法工艺流程所需的大部分设备，主要产品包括清洗机、刻蚀机、涂胶显影机、去胶机、烘箱、分片机等，产品线较为丰富。除光刻机及电镀机外，标的公司基本可以为客户提供一整条先进封装产线设备。标的公司目前发展战略即是先由先进封装切入客户，并争取对客户id提供所有先进封装产线设备，为客户做整体规划。随着标的公司核心客户的不断导入与深度覆盖，公司产品线布局齐全的优势将凸显，预计未来能够实现较高的成长性。

2、设计研发能力突出，并持续向前道工艺拓展

标的公司拥有自主研发的核心技术，并形成了一系列新型技术研发专利。标的公司自主研发的清洗机在集成电路后道先进封装领域技术水平相对领先，在定制化服务、交货周期等方面有一定竞争优势，能够深度绑定知名客户，并已基本具备出货前道清洗设备所需的技术能力；自主研发的全自动烘箱可实现烘烤流程全自动化，同时烘烤 104 片，大幅提升生产效率，国内厂商尚无对标产品。标的公司已发展成为具有一定国际背景与核心竞争力的半导体专用设备供应商，未来将以清洗机与全自动烘箱作为主力产品，持续向前道工艺拓展。

3、客户资源丰富，深度绑定知名半导体企业

客户方面，标的公司已建立良好合作关系的客户包括江阴长电先进封装有限公司、浙江禾芯集成电路有限公司、江苏芯德半导体科技有限公司、全球化半导体设计与制造企业 T 公司等知名半导体企业。在核心客户地位稳固的情况下，随着标的公司产品覆盖率的增加及技术的不断完善，客户对标的公司的服务态度、响应速度、定制化程度、交货周期等较为满意，能够深度绑定知名客户，并已基本具备出货前道清洗设备所需的技术能力。

会计师意见：

针对上述事项我们执行了以下核查程序：

1、了解并分析标的公司经营模式、研发能力及成本控制等；

2、询问标的公司采购部门主要采购政策及主要供应商，并对标的公司主要供应商进行询问并了解供应商供货模式、付款方式以及生产情况；

3、询问标的公司主要研发情况，并查验标的公司主要专利资质证书；

4、询问标的公司销售部门公司主要销售模式、市场占有率、行业地位及竞争优势，查验标的公司主要销售合同对应客户、结算方式以及交付验收、收入确认方法等；

5、检查复核有关生产循环审计底稿；

6、检查复核有关销售收款底稿；

7、检查复核有关采购付款底稿；

8、检查复核有关研发费用支出底稿；

结论：经核查，我们认为公司关于标的资产的主要经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有率、行业地位和竞争优势的分析说明符合标的资产现时实际情况。

三、结合上述情况，说明标的资产第三季度业绩大幅提升的具体原因，与行业趋势是否相符，并分析标的资产盈利能力的可持续性

上市公司回复：

（一）标的资产第三季度业绩大幅提升的具体原因

标的公司的收入主要包括销售设备及配件收入以及提供技术服务收入，两类收入的收入确认政策如下：

1、销售设备及配件收入：“本公司销售设备及配件的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的设备验收单或签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。”

2、提供技术服务收入：“本公司向客户提供技术劳务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据时间进度确定。”

根据标的公司提供的未经审计的财务数据，2022年第三季度，标的公司实现营业收入5,289.64万元，实现净利润1,203.21万元。其中：设备类收入5,117.08万元，服务费类收入69.99万元，其他收入102.57万元。

标的公司第三季度确认收入主要为设备收入，设备类产品以客户验收确认收入；由于部分设备有一定调试和验收周期，且受上半年疫情影响导致主要设备验收不及预期，因此确认收入为第三季度，与行业趋势相符。

（二）标的资产盈利能力的可持续性

截至 2022 年 11 月 4 日，标的公司在执行订单含税金额 6,710.16 万元，其中：设备类订单 6,520.06 万元，服务费订单 10.10 万元。从客户来源区分，新客户（2022 年 6 月后新增客户）订单 1,433.01 万，原有客户订单 5,277.15 万元。标的公司在维持原有客户稳定业务合作基础上，不断开发新客户，公司主流产品市场认可度逐步提升。此外，标的公司设计研发能力突出，主打产品具备一定的竞争优势，并深度绑定知名半导体企业，具体详见本问题回复之“二、（四）标的资产的竞争优势”。综上，标的公司盈利能力具有可持续性。

会计师意见：

针对上述事项我们执行了以下审计程序：

- 1、分析标的公司第三季度销售收入上升的主要原因；
- 2、查验标的公司第三季度销售合同、验收条款、提单及验收单；
- 3、查验标的公司主要销售合同回款情况。

经核查，我们未发现公司关于标的资产第三季度业绩大幅提升的具体原因、标的资产盈利能力的可持续性的分析说明存在重大异常。

四、标的资产今年前三季业绩是否已达到 2022 年业绩承诺，如是，请说明设置该等业绩承诺的合理性，相关约束力是否有限

上市公司回复：

（一）本次交易为市场化的独立第三方交易，业绩承诺非法定要求，交易双方基于市场化原则约定的业绩承诺有利于保护公司及全体股东的利益

本次交易为市场化的独立第三方交易，相关法规未要求交易对方必须进行业绩承诺及补偿安排。在本次交易谈判过程中，公司与交易对方根据市场化原则，在充分考虑标的公司所处行业发展趋势、国家产业政策及国产替代机遇、标的公司技术、产品、客户等因素后设置

了 2022 年、2023 年、2024 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,350 万元、1,890 万元、2,646 万元的业绩承诺指标，有利于保护公司及全体股东的利益。

在本次交易中，业绩承诺是整体交易方案的基础之一，业绩承诺与此次交易的标的公司估值、交易对价等直接挂钩，是整体交易方案的核心要素，如调整业绩承诺方案，将相应会导致标的公司估值的变化，若双方对方案调整无法达成一致，则本次交易将面临失败的风险，不利于保护公司及股东的利益。

并且标的公司产品种类布局较广，主流产品市场认可度正逐步提升，拥有自主研发的核心技术，能够深度绑定知名客户，并已基本具备出货前道清洗设备所需的技术能力，未来将持续向前道工艺拓展。若标的公司实际业绩达到乃至超过承诺业绩，将有利于提升上市公司整体业绩，实现本次交易战略目的，当前业绩承诺指标设置符合公司及全体股东的利益。

(二)2022 年前三季度实现的未经审计的净利润不代表标的资产已实现 2022 年业绩承诺

《购买资产协议》中，SUCCESS FACTORS 对苏州桔云作出业绩承诺为苏州桔云 2022 年、2023 年、2024 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,350 万元、1,890 万元、2,646 万元。

根据标的公司提供的未经审计的财务数据，2022 年前三季度，标的公司已实现营业收入 6,168.42 万元，实现净利润 1,365.96 万元（其中：非经常性损益 7.5 万元）。由于第三季度财务报表未经审计，标的公司前三季度业绩存在收入确认及费用调整的可能性，前述未经审计的净利润不代表标的公司已实现 2022 年的业绩承诺。

此外，标的公司部分费用支出未列支于 2022 年前三季度，包括但不限于年终奖及其他必要支出，标的公司也拟于第四季度扩大生产规模、增加设备及研发、销售等人员投入，标的公司第四季度的成本费用支出可能因此增加。同时，标的公司产品以收到客户验收单为依据确认收入，由于产品调试具有一定周期，收入确认时点可能根据实际情况有所调整，第四季度收入确认存在一定的不确定性。根据《购买资产协议》的约定，上市公司应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对各年度业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审核报告，并以经审计的业绩承诺期间内每一个会计年度的

扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润。因此，前三季度未经审计的数据也不代表标的公司 2022 年全年已实现 2022 年业绩承诺。

本次交易中 2022 年、2023 年、2024 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,350 万元、1,890 万元、2,646 万元，同比增长率均达到了 40%，实现业绩承诺对交易对方形成了较大压力，当前业绩承诺指标的设置能够有效约束交易对方和标的公司管理层。

综上，本次交易业绩承诺指标的设置具备合理性。

会计师核查意见：

针对上述事项我们执行了以下审计程序：

1、获取并核查标的公司三季度未申报表；检查相关销售合同；检查相关发货记录；检查回款记录；检查客户验收单；与公司沟通并分析公司关于设置业绩承诺的说明。

结论：经核查，我们未发现公司关于标的资产今年前三季业绩是否已达到 2022 年业绩承诺、设置该等业绩承诺的合理性、相关约束力是否有限的分析说明存在重大异常。

(此页为关于对深圳至正高分子材料股份有限公司对外收购事项的问询函回复报告号
中审亚太审字[2022]007516 号的盖章页，此页无正文)

